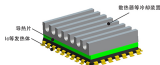


绝缘硅胶导热垫片

注重与元件的密合性以及压缩性，成功减小了安装时的热阻值。

通过充分发挥基础材料的柔软韧性，具备了对凹凸面的遵从性以及缓冲特性，具有能够与高度不均的零件密合，减轻对基板的应力，以及吸收公差等设计上的优势。

该系列产品兼具了性能和成本优势，方便安装拆卸。



各种特性

项目※1	单位	ST12XX	ST15XX	ST20XX	ST25XX
外观※2	-				
特征※3	-	双面粘合 或单面粘合 或加玻纤	双面粘合 或单面粘合 或加玻纤	双面粘合 或单面粘合 或加玻纤	双面粘合 或单面粘合 或加玻纤
热传导率※4	W/(m·K)	1.2	1.5	2.0	2.5
硬度	Shore C	20~60	20~60	20~60	20~60
比重	g/	2.0	2.2	2.5	2.7
体积电阻	Ω·cm	≥1X10 ¹⁰ *	≥1X10 ¹⁰ *	≥1X10 ¹⁰ *	≥1X10 ¹⁰ *
绝缘击穿强度	AC kV/mm	≥10	≥10	≥10	≥10
阻燃性	UL 94	V-0	V-0	V-0	V-0
厚度	mm	0.2 以上	0.2 以上	0.2 以上	0.2 以上
湿度使用范围	℃	-40~150	-40~150	-40~150	-40~150

※1 ST1230, XX:代表产品厚度, 例2产品硬度为Shore C 30度, 产品料号为ST1230

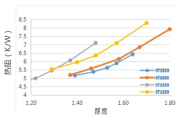
※2 产品颜色可以根据客户要求修改, 但建议采用带有散热颜色

※3 产品定为单面导热系数下限0.2W/mk, 产品料号后面加D, 例2: ST1230-D

产品增加玻纤导热系数下限0.4W/mk, 产品料号后面加Q, 例3: ST1230-Q

※4 测试面积706mm*2, 压力45N, 厚度3mm

热阻比较



热阻测试条件: 使用本公司制造的散热器测试装置, 样品尺寸10*10*2

※图、表中的测试值为实测值, 并非产品标准值

压缩率比较

